

設備作業標準(SE-028 電子槍蒸鍍系統)

1. MES 控制系統開啟設備
2. 操作前檢查項目：
 - 2.1. 檢查冷卻水水流量 $2\text{kg}/\text{cm}^2$
 - 2.2. 檢查氮氣二次盤面流量 $7\text{kg}/\text{cm}^2$
3. 鍍膜製程：
 - 3.1. 點選進入『半自動』畫面後按下【破真空】按鈕。
 - 3.2. 等待破真空結束，【ATM】亮起，放入試片、金屬錠、鎢舟和襯鍋等製程材料
 - 3.3. 設定膜厚計監控器
 - 3.3.1. 按下【Next Menu】選擇操控頁面
 - 3.3.2. 按下【Process Menu...】進入參數設定
 - 3.3.3. 選轉旋鈕至所需要的參數後按下【Edit...】，進入膜層順序設定
 - 3.3.4. 選轉旋鈕至所需要的參數後按下【Edit...】，進入膜層參數設定
 - 3.3.5. 更改【Init Rate】鍍膜速率 和更改【Final Thickness】，鍍膜厚度。
 - 3.3.6. 按下【To main】回到起始畫面
 - 3.4. 進入『鍍膜參數』畫面按下【Film 更新】後檢查和設定參數
 - 3.5. 進入『自動』畫面
 - 3.5.1. 按下【更新】，並選擇參數
 - 3.5.2. 按下【自動鍍膜】
 - 3.6. 等真空達基本壓力(Base pressure)，約為 $8\text{E}-7$ Torr，聽到提示音後，按下【鍍膜】
 - 3.7. 進入『資料收集』畫面內監控鍍膜情形
 - 3.8. 鍍膜厚度達到後，結束鍍膜製程
 - 3.9. 破真空，拿取試片和清潔腔體
4. 回『半自動』畫面，選取【抽真空】
5. MES 控制系統 關閉設備。